PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-241211

(43) Date of publication of application: 11.09.1998

(51)Int.CI.

G11B 7/26

(21)Application number: 09-059837

(71)Applicant: TDK CORP

(22)Date of filing:

27.02.1997

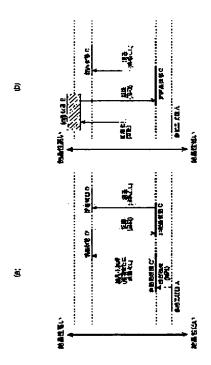
(72)Inventor: TAKAHASHI MAKOTO

UTSUNOMIYA HAJIME

(54) PRODUCTION OF OPTICAL RECORDING MEDIUM (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate the need for repetition of recording and erasing which are heretofore required to be executed after initialization treatment and before shipping of phase transition type optical recording mediums and the embody a good repetitive recording characteristic.

SOLUTION: At the time of producing the phase transition type optical recording mediums, this process is provided with a reforming treatment stage and a crystallization treatment stage in succession thereto in place of the conventional initialization treatment. This reforming treatment stage is a stage for melting and cooling the recording layer in a non-crystalline state formed by a supporting method, thereby putting the recording layer into the non-crystalline state different from the non-crystalline state right after the formation. The crystallization treatment stage is a stage for crystallizing the recording layer in the non-crystalline state after the reforming treatment by heating.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-241211

(43)公開日 平成10年(1998)9月11日

(51) Int.Cl.4

識別記号

FΙ

G11B 7/26

G11B 7/26

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 15 頁)

(21)出顯番号

特顧平9-59837

(22)出顧日

平成9年(1997)2月27日

(71)出顧人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72) 発明者 髙橋 真

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(72)発明者 宇都宮 肇

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

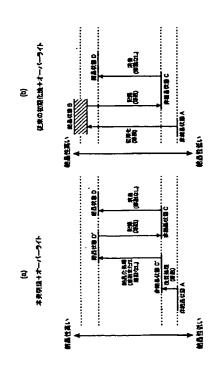
ーディーケイ株式会社内

(74)代理人 弁理士 石井 陽一

(54) 【発明の名称】 光記録媒体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 相変化型光記録媒体において、従来、初期化処理後、出荷前に行う必要があった記録・消去の繰り返しを不要とし、かつ良好な繰り返し記録特性を実現する【解決手段】 相変化型光記録媒体を製造する際に、従来の初期化処理に替えて、改質処理工程と、これに続く結晶化処理工程とを設ける。改質処理工程は、スパッタ法により形成した非結晶状態の記録層を、溶融して冷却することにより、形成直後の非結晶状態とは異なる非結晶状態とする工程であり、結晶化処理工程は、改質処理後の非結晶状態の記録層を加熱することにより結晶化する工程である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体上に相変化型の記録層を有する光記 録媒体を製造する方法であって、

スパッタ法により形成した非結晶状態の記録層を、溶融 して冷却することにより、形成直後の非結晶状態とは異 なる非結晶状態とする改質処理工程と、この改質処理工 程に続いて、非結晶状態の記録層を加熱することにより 結晶化する結晶化処理工程とを有する光記録媒体の製造

【請求項2】 前記改質処理工程において、形成直後の 10 いる。 記録層に、パルス変調したレーザービームを照射する請 求項1の光記録媒体の製造方法。

【請求項3】 前記記録層が、Ge、SbおよびTeを 含有する請求項1または2の光記録媒体の製造方法。

【請求項4】 前記記録層が、Ag、In、Sbおよび Teを含有する請求項1または2の光記録媒体の製造方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、相変化型光記録媒 20 体の製造方法、より詳しくは初期化方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、高密度記録が可能で、しかも記録 情報を消去して書き換えることが可能な光記録媒体が注 目されている。書き換え可能型の光記録媒体のうち相変 化型のものは、レーザー光を照射することにより記録層 の結晶状態を変化させて記録を行い、このような状態変 化に伴なう記録層の反射率変化を検出することにより再 生を行うものである。相変化型の光記録媒体は単一の光 ビームの強度を変調することによりオーバーライトが可 30 能であり、また、駆動装置の光学系が光磁気記録媒体の それに比べて単純であるため、注目されている。

【0003】相変化型の光記録媒体には、結晶質状態と 非晶質状態とで反射率の差が大きいこと、非晶質状態の 安定度が比較的高いことなどから、Ge-Te系材料が 用いられることが多いが、最近、カルコパイライトと呼 ばれる化合物を応用することが提案されている。

【0004】カルコパイライト型化合物は化合物半導体 材料として広く研究され、太陽電池などにも応用されて いる。カルコパイライト型化合物は、化学周期律表を用 40 いるとIb-IIIb-VIb2やIIb-IVb-Vb2で表わされる組成で あり、ダイヤモンド構造を2つ積み重ねた構造を有す る。カルコパイライト型化合物はX線構造解析によって 容易に構造を決定することができ、その基礎的な特性 は、例えば月刊フィジクスvol. 8, No. 8, 1987, pp-441や、 電気化学vol. 56, No. 4, 1988, pp-228などに記載されてい る。

【0005】これらのカルコパイライト型化合物の中で 特にAgInTe2は、SbやBiを用いて希釈するこ

として使用できることが知られている(特開平3-24 0590号公報、同3-99884号公報、同3-82 593号公報、同3-73384号公報、同4-151 286号公報等)。

【0006】このようなカルコパイライト型化合物を用 いた相変化型光記録媒体の他、特開平4-267192 号公報や特開平4-232779号公報、特開平6-1 66268号公報には、記録層が結晶化する際にAgS bTe₂相が生成する相変化型光記録媒体が開示されて

【0007】従来の相変化型光記録媒体では、真空成膜 装置などを用いて記録層を形成しているため、形成直後 の記録層は非晶質状である。これを書き換え型の媒体と して利用する場合には、一般に初期化と呼ばれる操作に より、記録層を結晶化する必要がある。

【0008】初期化の方法としては、成膜後に記録層の 結晶化温度まで基板を加熱して結晶化させる方法(特開 平2-3131号公報)、成膜後にレーザービームを照 射して結晶化させる固相初期化と呼ばれる方法(特開平 4-366424号公報、同2-201734号公報、 同3-76027号公報)、カルコゲン化合物の光特性 を利用してフラッシュ光を成膜後の基板に照射し、いわ ゆる光黒化によって擬似的に結晶化させる方法(特開平 4-281219号公報)、髙周波を用いて誘導加熱に よって結晶化させる方法、成膜中に基板を加熱して結晶 化させる方法(特開平2-98847号公報)、第1層 目の誘電体を形成し、次いで記録層を形成した後、これ を加熱して結晶化し、さらに誘電体を形成する方法 (特 開平2-5246号公報)などが提案されている。

【0009】しかし、レーザービーム照射による初期化 は長時間を要し、生産性に問題がある。また、媒体全体 を加熱する方法では、安価な樹脂基板を使いにくいとい う問題がある。すなわち、初期化処理の際の加熱によっ て樹脂基板が歪み、トラッキングなどに支障をきたすよ うになってしまう。また、フラッシュ光を用いる方法で は、完全に結晶化するためには複数回の照射が必要であ り、生産性に問題がある。

【0010】このため、現在、工業的に適当な方法とし て利用されているのは、バルクイレーザーと呼ばれる装 置を用いる方法である。バルクイレーザーは、出力の高 いガスレーザーや半導体レーザーのビームをあまり絞ら ずに照射して、多数のトラックを一挙に結晶化させる装 置である。バルクイレーザーでは、記録層を限定的に加 熱できるため基板の温度上昇が小さくなるので、耐熱性 の低い樹脂基板の利用が可能である。

【0011】従来、相変化型光記録媒体では、上記した バルクイレーザー等による初期化処理後、出荷する前 に、いわゆる「なじませ」と呼ぶ処理を施す必要があ る。「なじませ」処理は、数十回程度の記録・消去を繰 とにより、線速度 7 m/s前後の光記録媒体の記録層材料 50 り返す作業である。「なじませ」処理が必要な理由を、

図1 (b) により説明する。

【0012】図1(b)は、相変化型記録層の形成直後、初期化処理後およびオーバーライト後の各段階での記録層の結晶性を示すものである。図1(b)では、縦軸が結晶性の高低を表す。

【0013】スパッタ法により形成された記録層は、非結晶状態である。これを非結晶状態Aとする。この状態の記録層を従来の方法で初期化すると、記録層は結晶化する。初期化処理では、通常、記録層をいったん溶融し、徐冷する。初期化処理後の状態を結晶状態Bとする。初期化後の記録層に記録を行うと、記録層は融点付近まで加熱された後、急冷され、非結晶状態の記録マークが形成される。これを非結晶状態Cとする。記録後、結晶化する温度以上であって溶融する温度未満の加熱を行って、記録マークを結晶化する。これがオーバーライト時の消去である。消去後の状態を、結晶状態Dとする。

【0014】図1(b)において、初期化後の結晶状態 Bと消去後の結晶状態 Dとは、記録層が結晶状態である 点では同じであるが、結晶性が異なり、初期化後の結晶 20 状態Bのほうが結晶性が高い。具体的には、溶融した後に結晶化した結晶状態 Bでは、溶融せずに結晶化した結晶状態 Dよりも結晶粒が大きくなる。このように、初期 化処理時に結晶化した領域とオーバーライト時に結晶化した領域とでは結晶性が異なるため、反射率も異なることになり、オーバーライト領域が記録層全面に及ぶまでは反射率が安定しない。書き換え型のデジタルビデオディスク(DVD-RAM)などで利用されるマークエッジ記録の場合には、このような反射率のばらつきが生じると、マークエッジと誤認されるという問題が生じ得 30 る。

【0015】上記した「なじませ」処理は、初期化処理 による結晶化と消去による結晶化との結晶性の違いを解 消するためになされる。

【0016】しかし、「なじませ」処理は長時間を要するため、生産性を著しく低下させてしまう。

【0017】従来の初期化処理には、このほかにも、バルクイレーザーを用いることによる以下のような問題もある。

【0018】バルクイレーザーでは、12cm径の光記録 40 ディスクを初期化するときでさえ数十秒間から数分間程度の時間が必要であるため、光記録ディスク生産工程における律速段階となっている。

【0019】また、バルクイレーザーでは、出力の高いレーザーで一度に多数のトラックを初期化するために、次の問題が生じる。

【0020】バルクイレーザーでは、ビームスポットを あまり絞らずに大きくしているが、スポット内のエネル ギー密度は均一ではなく、また、ビームスポットを螺旋 状に走査する際に、前の周に走査した領域の一部とオー 50 4

バーラップさせるため、初期化された部分の結晶状態は それぞれのトラックで異なることになる。このため、初 期化処理後の反射率がトラック間でばらついてしまい、

「なじませ」処理が必須となるほか、「なじませ」処理時に駆動装置のフォーカスサーボ不良を引き起こすこともある。また、基板にあらかじめピットを形成してあるプレピット部は、再生専用であってオーバーライトが行われないため、プレピット部において初期化処理時に生じた反射率のばらつきは「なじませ」処理によって解消することはない。このため、プレピット部におけるサーボや再生に関して、問題を生じることがある。なお、図1(b)では、このようなばらつきを、結晶状態Bに縦軸方向の幅をもたせて表現している。

【0021】また、バルクイレーザーはピームスポット が大きいため、全エネルギーに対する1トラックあたり のエネルギーが低くなる。これを補うために、初期化完 了までに同一トラックを複数回照射したり、レーザーパ ワーを大きくしたりする必要がある。この結果、記録層 やその上下に設けられる誘電体層にダメージを与え、繰 り返し記録特性の低下と共に反射率の変化も招く。ま た、バルクイレーザーは、多数のトラックを同時に初期 化する、すなわち初期化面積が大きい。このため、記録 層が溶融したとき、1トラックごとに初期化する場合よ りも大きな応力が誘電体層に生じ、記録層および誘電体 層のダメージが大きくなる。しかも、バルクイレーザー では、上記したようにビーム内に強度分布があり、ま た、オーバーラップ照射をおこなうので、上記ダメージ はトラック間で異なることになる。このダメージによる 反射率変化は、上記した「なじませ」処理によっても完 30 全に解消することはできないので、結晶化部に反射率の ばらつきが存在し、これがジッターの増大や駆動装置の サーボ不良を招く。

[0022]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、相変 化型光記録媒体において、従来、初期化処理後、出荷前 に行う必要があった記録・消去の繰り返しを不要とし、 かつ良好な繰り返し記録特性を実現することである。

[0023]

【課題を解決するための手段】このような目的は、下記 (1)~(4)のいずれかの構成により達成される。

- (1) 基体上に相変化型の記録層を有する光記録媒体を製造する方法であって、スパッタ法により形成した非結晶状態の記録層を、溶融して冷却することにより、形成直後の非結晶状態とは異なる非結晶状態とする改質処理工程と、この改質処理工程に続いて、非結晶状態の記録層を加熱することにより結晶化する結晶化処理工程とを有する光記録媒体の製造方法。
- (2) 前記改質処理工程において、形成直後の記録層 に、パルス変調したレーザービームを照射する上記
-) (1)の光記録媒体の製造方法。

(3) 前記記録層が、Ge、SbおよびTeを含有す る上記(1)または(2)の光記録媒体の製造方法。

前記記録層が、Ag、In、SbおよびTeを 含有する上記(1)または(2)の光記録媒体の製造方 法。

[0024]

【作用および効果】上記「なじませ」処理が必要となる のは、上述したように初期化処理直後の結晶性と繰り返 し記録後の結晶化部の結晶性とが異なるためである。ま た、「なじませ」処理によっても解消し得ない反射率変 10 ージが従来の初期化処理に比べ著しく小さい。このた 動は、形成直後の非結晶状態の記録層をパルクイレーザ 一により一挙に結晶化することによるダメージのためで ある。

【0025】生産性を著しく低下させる「なじませ」処 理を省き、また、「なじませ」によっても完全には解消 しない反射率変動を防ぐためには、形成直後の非結晶状 態Aを、記録層を溶融させることなく結晶状態Dとする こと、すなわち、初期化により形成される結晶状態Bを 経ずに、形成直後の非結晶状態Aから直接、消去後の結 非結晶化された非結晶状態Cに比べ、スパッタ法により 形成された非結晶状態Aはランダム性が高いため、記録 層を溶融させることなく結晶化して結晶状態Dとするた めには高パワーのレーザー光を長時間照射しなければな らず、実用的ではない。

【0026】これに対し本発明では、図1(a)に示す ように、従来、初期化→記録の過程で形成される記録マ ークの非結晶状態Cとほぼ同じランダム性を有する結晶 状態C'を、まず、改質処理により形成する。すなわ ち、改質処理により、形成直後の非結晶状態Aから、同 30 ば、パルス変調したレーザービームを照射する方法が好 じく非結晶ではあるがランダム性の異なる非結晶状態 C'とする。改質処理は、記録層を溶融して急冷する処 理である。

【0027】次いで、記録層を加熱することにより結晶 化処理を施し、消去後の結晶状態Dとほぼ同じ結晶性を 有する結晶状態D'とする。改質処理後の非結晶状態 C'は、結晶のランダム性が記録マークの非結晶状態C とほぼ同じであるため、改質処理後の非結晶状態C'を 結晶化させて結晶状態D'にするためには、通常の消去 操作と同様に低パワーのレーザー光を短時間照射するだ 40 けですむ。結晶化処理に際しては、記録層を溶融しても よく、溶融せずに固相で結晶化してもよい。

【0028】本発明では、従来の初期化処理工程に替え て、改質処理工程と結晶化処理工程とを続けて設けるこ とにより、結晶化処理後に繰り返しオーバーライト後の 結晶性(消去後の結晶状態D)と同等の結晶性(結晶状 態D') が得られるので、従来必須であった「なじま せ」が不必要になる。このため、生産性が著しく向上す

【0029】上述したように従来の初期化処理では、バ 50 速度を速くして冷却速度を速くすればよい。この場合の

6

ルクイレーザーで同一トラックを複数回照射したり、バ ルクイレーザーのレーザーパワーを大きくしたりする必 要があり、この結果、記録層やその上下に設けられる誘 電体層にダメージを与え、繰り返し記録特性の低下と共 に反射率変動を招いていた。一方、本発明では、改質処 理に要するパワーは従来の初期化処理より小さくならな いが、改質処理では非結晶状態C'とするために、パル ス変調したレーザービームを用いたり線速度を速くした りすることにより記録層を急冷するので、熱によるダメ め、改質処理にバルクイレーザーを用いた場合でも、記 録層や誘電体層のダメージを防ぐことができ、「なじま せ」処理によっても解消し得ない反射率変動を防ぐこと ができる。

[0030]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て詳細に説明する。

【0031】改質処理および結晶化処理

本発明では、まず、従来と同様にスパッタ法により相変 晶状態Dとすることが必要である。しかし、記録により 20 化型の記録層を形成する。形成された記録層は非結晶状 態[図1(a)の非結晶状態A]である。

> 【0032】続いて、記録層に改質処理を施す。この改 質処理は、記録層を溶融して冷却することにより、非結 晶状態Aとは異なる非結晶状態 [図1 (a) の非結晶状 態C′〕とするものである。

> 【0033】改質処理工程において、記録層を溶融する ために用いる方法は特に限定されず、非結晶状態Aから 非結晶状態C'に変化させ得る方法であればどのような ものであってもよい。このような方法としては、例え ましい。改質処理には、従来の初期化処理と同様にパル クイレーザーを用いることが生産性の点で好ましいが、 バルクイレーザーのレーザーピームをパルス変調するこ とにより部分的にエネルギーを抜くことになるため、バ ルクイレーザーを用いて従来の初期化処理と同等の線速 度で改質処理を行った場合でも、非結晶状態C' が容易 に得られると共に、記録層や誘電体層のダメージを防ぐ こともできる。

> 【0034】パルス変調周波数は特に限定されない。最 適なパルス変調周波数はレーザーパワーやレーザービー ムの線速度等の各種条件に応じて異なるので、記録マー ク非結晶状態C'に相当する反射率が得られるように実 験的に決定すればよいが、通常、1MHz以上、好ましく は5MHz以上、より好ましくは8MHz以上である。パルス 変調周波数の上限は特にないが、バルクイレーザー等の 比較的パワーの大きな装置では、通常、10MHzを超え る変調周波数とすることは困難である。

> 【0035】なお、パルス変調しないレーザービームを 用いる場合には、髙パワーのレーザービームを用い、線

レーザービームのパワーおよび線速度の好ましい範囲 は、レーザービームのスポット径や記録層の組成によっ ても異なるため、非結晶状態C'に相当する反射率が得 られるように実験的に決定すればよい。

【0036】改質処理工程に続いて、記録層を加熱する ことにより結晶状態 [図1 (a) の結晶状態D'] とす る結晶化処理工程を設ける。この結晶化処理工程では、 結晶化温度以上まで記録層を昇温する。なお、結晶化処 理に際しては、記録層を溶融させて結晶化してもよく、 記録層を溶融させない程度の加熱を行い、固相状態で結 10 好ましく、硫化物生成標準自由エネルギーが小さいこと 晶化してもよい。

【0037】結晶化処理工程における各種条件は特に限 定されず、結晶状態D'に相当する反射率が得られるよ うに実験的に決定すればよい。

【0038】図2の媒体構成

本発明が適用される光記録媒体の具体的な構成例を図2 に示す。同図において光記録媒体は、基体2上に第1誘 電体層31、記録層4、第2誘電体層32、反射層5お よび保護層6を有する。

【0039】 基体この構成の光記録媒体では基体2を通 20 して記録層4に光ビームが照射されるので、基体2は、 用いる光ビームに対して実質的に透明である材質、例え ば、樹脂やガラスなどから構成されることが好ましい。 樹脂としては、アクリル樹脂、ポリカーボネート、エポ キシ樹脂、ポリオレフィン等を用いればよい。基体の形 状および寸法は特に限定されないが、通常、ディスク状 とし、厚さは0.5~3㎜程度、直径は50~360㎜ 程度とする。基体の表面には、トラッキング用やアドレ ス用等のために、グループ等の所定のパターンが必要に 応じて設けられる。

【0040】誘電体層

第1誘電体層31は、記録層の酸化を防ぎ、また、記録 時に記録層から基体に伝わる熱を遮断して基体を保護す る。第2誘電体層32は、記録層を保護すると共に、記 録後、記録層に残った熱を熱伝導により放出するために 設けられる。また、両誘電体層を設けることにより、変 調度を向上させることができる。

【0041】第1誘電体層および第2誘電体層に用いる 誘電体材料は特に限定されず、各種誘電体やそれらの混 合物、例えば、酸化ケイ素、窒化ケイ素、ZnS-Si 40 ンタン(La2O3)、窒化ケイ素(Si3N4)、窒化ア O2など、透明な各種セラミックスを用いればよく、ま た、各種ガラスなどを用いてもよい。また、例えば、L a、Si、OおよびNを含有する所謂LaSiONや、Si、 Al、OおよびNを含有する所謂SiAlON、あるいはYを 含有するSiAlON等も好ましく用いることができる。

【0042】ただし、第1誘電体層および第2誘電体層 の少なくとも一方には、屈折率等の特性の最適化のため に硫化亜鉛を含有させることが好ましい。以下、硫化亜 鉛を含有する誘電体層をZnS含有誘電体層という。そ して、2nS含有誘電体層には、0~1000℃におい 50 含有量は、好ましくは50~95モル%、より好ましく

てその硫化物生成標準自由エネルギーがZnS生成標準 自由エネルギーより低い元素(以下、金属元素Aとい う) を含有させることが好ましい。 Z n S含有誘電体層 中に金属元素Aを含有させることにより、繰り返しオー バーライトの際のS遊離を抑制することができ、これに よりジッター増大を防ぐことができ、繰り返しオーバー ライト可能な回数を増やすことができる。

【0043】金属元素Aとしては、Ce、Ca、Mg、 Sr、BaおよびNaの少なくとも1種を用いることが から、Ceを用いることが特に好ましい。例えば300 Kでは、ZnS生成標準自由エネルギーは約-230kJ /mol、CeS生成標準自由エネルギーは約-540kJ/m ol、CaS生成標準自由エネルギーは約-510kJ/mo 1、MgS生成標準自由エネルギーは約-390kJ/mo SrS生成標準自由エネルギーは約-500kJ/mo 1、BaS生成標準自由エネルギーは約-460kJ/mo 1、Na2S生成標準自由エネルギーは約-400kJ/mol である。

【0044】ZnS含有誘電体層中において、全金属元 案に対する金属元素Aの比率は、2原子%未満、好まし くは1. 5原子%以下、より好ましくは1. 3原子%以 下である。金属元素Aの比率が高すぎると、繰り返しオ ーバーライト時のジッター増大抑制効果が実現しない。 なお、金属元素Aの添加による効果を十分に実現するた めには、金属元素Aの比率を好ましくは0.01原子% 以上、より好ましくは0.03原子%以上とする。全金 属元素中の金属元素Aの比率は、蛍光X線分析やEPM A(電子線プローブX線マイクロアナリシス)などによ 30 り測定することができる。なお、誘電体層中における全 金属には、Si等の半金属も含まれるものとする。

【0045】誘電体層中において、金属元素Aは、単 体、硫化物、酸化物、フッ化物等のいずれの形態で存在 していてもよい。

【0046】 Zn S含有誘電体層には、硫化亜鉛以外の 化合物、例えば、各種酸化物、窒化物、フッ化物等が含 有されていることが好ましい。このような化合物として は、例えば、酸化ケイ素 (SiO2、SiO)、酸化タ ンタル (T a 2O5) 、酸化チタン (T i O2) 、酸化ラ ルミニウム (A 1 N) 、フッ化マグネシウム (Mg F2)、フッ化ナトリウム (NaF) およびフッ化トリ ウム (ThF4) の少なくとも1種が好ましい。誘電体 層を実質的に硫化亜鉛だけから構成した場合には誘電体 層が硬くなりすぎ、繰り返しオーバーライトを行ったと きの熱衝撃により剥離が生じるなど、耐久性が低くなっ てしまうが、酸化ケイ素や窒化ケイ素などを含有させる ことにより、オーバーライト耐久性が向上する。

【0047】ZnS含有誘電体層中における硫化亜鉛の

は70~90モル%である。2nSが少なすぎると、熱 伝導率が高くなりすぎると共に屈折率が小さくなりす ぎ、高C/Nが得られにくくなる。一方、ZnSが多す ぎると、オーバーライト耐久性が低くなってしまう。誘 電体層中のZnS含有量は、蛍光X線分析などにより求 めたS量とZn量とに基づいて決定し、例えばSに対し Znが過剰であった場合には、過剰なZnは他の化合 物、例えばZnOとして含有されているものとする。

【0048】なお、以上ではZnS含有誘電体層中に金 属元素Aを含有させる構成について説明したが、ZnS 10 含有誘電体層と記録層との間に金属元素Aを含有する中 間層を設ける構成としてもよい。このような中間層とし ては、例えば、酸化セリウム (CeO2) 単体からなる もの、あるいはZnS-CeO₂混合物からなるものな どが挙げられる。

【0049】第1誘電体層および第2誘電体層の一方だ けをZnS含有誘電体層とする場合、他方の誘電体層、 すなわち硫化亜鉛を含有しない誘電体層に用いる誘電体 材料は特に限定されず、ZnS以外の上記各種誘電体を 用いればよい。

【0050】第1誘電体層および第2誘電体層の屈折率 は、波長400~850nmの範囲で1.4以上、特に 1. 8以上であることが好ましい。上記波長範囲は、現 在のCDプレーヤの使用波長である780nmや、次世代 の記録波長として実用化が進められている630~68 Onmを含むものであり、本発明の光記録媒体に対し好ま しく使用される波長範囲である。

【0051】第1誘電体層31の厚さは、好ましくは5 0~300nm、より好ましくは100~250nmであ る。第1誘電体層をこのような厚さとすることにより、 記録に際しての基体損傷を効果的に防ぐことができ、し かも変調度も高くなる。第2誘電体層32の厚さは、好 ましくは10~30m、より好ましくは13~20nmで ある。第2誘電体層をこのような厚さとすることにより 冷却速度が速くなるので、記録マークのエッジが明瞭と なってジッターが少なくなる。また、このような厚さと することにより、変調度を高くすることができる。

【0052】各誘電体層は、スパッタ法や蒸着法等の気 相成長法により形成することが好ましい。誘電体層中に 金属元素Aを含有させるためには、様々な方法を利用す 40 ることができる。例えば、金属元素AがCeである場合 には、Ce単体やCeO2からなるチップを、誘電体層 の主成分となる主ターゲット上に載せたものをターゲッ トとして用いてもよく、主ターゲット中にCeO₂やそ の他のCe化合物として含有させてもよい。また、金属 元素AとしてCaやMgを用いる場合、上記主ターゲッ ト上にCaOやMgOからなるチップを載せてターゲッ トとしてもよいが、これらには潮解性があるので、好ま しくない。したがって、この場合には、CaFzやMg

10

トとすることが好ましい。金属元素AとしてSr、B a、Naなどを用いる場合も、潮解性の点で、酸化物チ ップよりもフッ化物チップを用いるほうが好ましい。ま た、Ca、Mg、Sr、Ba、Naは、酸化物やこれ以 外の化合物として主ターゲット中に含有させて用いても よい。なお、主ターゲットには、2nS-SiO2など のような複合ターゲットを用いてもよく、主ターゲット としてZnSとSiOzとをそれぞれ単独で用いるよう な多元スパッタ法を利用してもよい。

【0053】ZnS含有誘電体層は、Ar中で通常のス パッタ法により形成してもよいが、上記金属元素Aを含 有させる場合には、好ましくはArとO2との混合雰囲 気中でスパッタを行う。このような混合雰囲気中でスパ ッタを行うことにより、繰り返しオーバーライト時のジ ッター増大を抑える効果が、より高くなる。スパッタ時 のOz導入は、金属元素A単体からなるチップを上記主 · ターゲット上に載せてスパッタを行う場合に特に有効で あるが、金属元素Aの化合物からなるチップを主ターゲ ットに載せたり、主ターゲットに金属元素Aの化合物を 20 含有させたりする場合にも有効である。スパッタ雰囲気 中へのOz導入量を分圧比Oz/(Ar+Oz)で表した とき、この分圧比は好ましくは30%以下、より好まし くは25%以下である。O2導入量が多すぎると、記録 パワーは低下するが消去パワーは変化しないため、消去 パワーマージンが極度に狭くなってしまい、好ましくな い。なお、O2導入による効果を十分に発揮させるため には、上記分圧比を好ましくは5%以上、より好ましく は10%以上とする。

【0054】記録層

30 記録層の組成は、従来の初期化処理に替えて上述した改 質処理と結晶化処理とが可能なものであれば特に限定さ れないが、以下に説明するIn-Ag-Te-Sb系組 成やGe-Sb-Te系組成、特にIn-Ag-Te-Sb系組成に対し、本発明は特に有効である。

【0055】In-Ag-Te-Sb系組成の記録層で は、構成元素の原子比を

式I { (InaAgbTe1-a-b) 1-cSbc} 1-dMd で表したとき、好ましくは

 $a = 0.1 \sim 0.3$

 $b = 0.1 \sim 0.3$

 $c = 0.5 \sim 0.8$

 $d = 0 \sim 0.05$

であり、より好ましくは

 $a = 0. 11 \sim 0. 28$

 $b = 0.15 \sim 0.28$ $c = 0.55 \sim 0.65$

d = 0. $005 \sim 0$. 05

【0056】式Iにおいてaが小さすぎると、記録層中 F2からなるチップを主ターゲット上に載せてターゲッ 50 のIn含有率が相対的に低くなりすぎる。このため、記 録マークの非晶質化が不十分となって変調度が低下し、 また、信頼性も低くなってしまう。一方、aが大きすぎ ると、記録層中のIn含有率が相対的に高くなりすぎ る。このため、記録マーク以外の反射率が低くなって変 調度が低下してしまう。

【0057】式Iにおいてbが小さすぎると、記録層中 のAg含有率が相対的に低くなりすぎる。このため、記 録マークの再結晶化が困難となって、繰り返しオーバー ライトが困難となる。一方、bが大きすぎると、記録層 中のAg含有率が相対的に高くなり、過剰なAgが記録 10 0原子%以下、より好ましくは20原子%以下である。 および消去の際に単独でSb相中に拡散することにな る。このため、書き換え耐久性が低下すると共に、記録 マークの安定性および結晶質部の安定性がいずれも低く なってしまい、信頼性が低下する。すなわち、高温で保 存したときに記録マークの結晶化が進んで、C/Nや変 調度が劣化しやすくなる。また、繰り返して記録を行な ったときのC/Nおよび変調度の劣化も進みやすくな る。

【0058】また、a+bが小さすぎるとTeが過剰と なってTe相が形成される。Te相は結晶転移速度を低 20 程度、微結晶ないし非晶質のときが2.2程度である。 下させるため、消去が困難となる。一方、a+bが大き すぎると、記録層の非晶質化が困難となり、信号が記録 できなくなる可能性が生じる。

【0059】式Iにおいてcが小さすぎると、相変化に 伴なう反射率差は大きくなるが結晶転移速度が急激に遅 くなって消去が困難となる。一方、cが大きすぎると、 相変化に伴なう反射率差が小さくなって変調度が小さく なる。

【0060】式Iにおける元素Mは、H、Si、C、 V、W、Ta、Zn、Ti、Ce、TbおよびYから選 30 択される少なくとも1種の元素である。元素Mは、書き 換え耐久性を向上させる効果、具体的には、書き換えの 繰り返しによる消去率の低下を抑える効果を示す。ま た、高温・高温などの悪条件下での信頼性を向上させ る。このような効果が強力であることから、元素Mのう ちV、Ta、CeおよびYの少なくとも1種が好まし く、VおよびTaの少なくとも1種がより好ましく、V が特に好ましい。

【0061】元素Mの含有率を表すdが大きすぎると、 相変化に伴なう反射率変化が小さくなって十分な変調度 40 なり、その結果、Sbが析出して記録マークが形成しに が得られなくなる。dが小さすぎると、元素M添加によ る効果が不十分となる。

【0062】この組成系では、記録層にはAg、Sb、 Te、Inおよび必要に応じて添加されるMだけを用い ることが好ましいが、Agの一部をAuで置換してもよ く、Sbの一部をBiで置換してもよく、Teの一部を Seで置換してもよく、Inの一部をAlおよび/また はPで置換してもよい。

【0063】AuによるAgの置換率は、好ましくは5 0原子%以下、より好ましくは20原子%以下である。 50 分となる。一方、記録層が厚すぎると、反射率および変

置換率が高すぎると、記録マークが結晶化しやすくなっ て高温下での信頼性が悪化する。

【0064】BiによるSbの置換率は、好ましくは5 0原子%以下、より好ましくは20原子%以下である。 置換率が高すぎると記録層の吸収係数が増加して光の干 渉効果が減少し、このため結晶-非晶質間の反射率差が 小さくなって変調度が低下し、高C/Nが得られなくな ろ.

【0065】SeによるTeの置換率は、好ましくは5 置換率が高すぎると結晶転移速度が遅くなりすぎ、十分 な消去率が得られなくなる。

【0066】Alおよび/またはPによるInの置換率 は、好ましくは40原子%以下、より好ましくは20原 子%以下である。置換率が高すぎると、記録マークの安 定性が低くなって信頼性が低くなる。なお、AlとPと の比率は任意である。

【0067】なお、この組成系において繰り返し書き換 え後の記録層の吸収係数 k は、結晶状態のときが3.3 【0068】この組成系の記録層の厚さは、好ましくは

9. 5~50nm、より好ましくは13~30nmである。 記録層が薄すぎると結晶相の成長が困難となり、相変化 に伴なう反射率変化が不十分となる。一方、記録層が厚 すぎると、記録マーク形成時に記録層の厚さ方向へAg が多量に拡散し、記録層面内方向へ拡散するAgの比率 が小さくなってしまうため、記録層の信頼性が低くなっ てしまう。また、記録層が厚すぎると、反射率および変 調度が低くなってしまう。

【0069】Ge-Sb-Te系組成の記録層では、構 成元素の原子比を

式II GeaSbbTe1-a-b で表わしたとき、好ましくは $0.08 \le a \le 0.25$

 $0.20 \le b \le 0.40$ である。

【0070】式IIにおいてaが小さすぎると、記録マー クが結晶化しにくくなり、消去率が低くなってしまう。 aが大きすぎると、多量のTeがGeと結合することに くくなる。

【0071】式IIにおいてbが小さすぎると、Teが多 くなりすぎるために高温での保存時に記録マークが結晶 化しやすくなって、信頼性が低くなってしまう。bが大 きすぎると、Sbが析出して記録マークが形成しにくく なる。

【0072】この組成系における記録層の厚さは、好ま しくは14~50nmである。記録層が薄すぎると結晶相 の成長が困難となり、相変化に伴なう反射率変化が不十

調度が低くなってしまう。

【0073】記録層の組成は、EPMAやX線マイクロ アナリシス、ICPなどにより測定することができる。 【0074】記録層の形成は、スパッタ法により行う。 スパッタ条件は特に限定されず、例えば、複数の元素を 含む材料をスパッタする際には、合金ターゲットを用い てもよく、ターゲットを複数個用いる多元スパッタ法を 用いてもよい。

【0075】反射層

u、Ag、Pt、Cu等の単体あるいはこれらの1種以 上を含む合金などの高反射率金属から構成すればよい。 反射層の厚さは、30~200mとすることが好まし い。厚さが前記範囲未満であると十分な反射率が得にく くなる。また、前記範囲を超えても反射率の向上は小さ く、コスト的に不利になる。反射層は、スパッタ法や蒸 着法等の気相成長法により形成することが好ましい。

【0076】保護層

保護層6は、耐擦傷性や耐食性の向上のために設けられ とが好ましいが、特に、放射線硬化型化合物やその組成 物を、電子線、紫外線等の放射線により硬化させた物質 から構成されることが好ましい。保護層の厚さは、通 常、0.1~100μπ程度であり、スピンコート、グ ラピア塗布、スプレーコート、ディッピング等、通常の 方法により形成すればよい。

【0077】図3の媒体構成

図3に、本発明が適用される光記録媒体の他の構成例を 示す。この構成の光記録媒体は、オーバーライトによる ジッター増大を抑制することを目的とするものであり、 例えば特開平8-124218号公報などに記載されて いる。この光記録媒体は両面記録型であり、基体2上に 第1誘電体層31、記録層4、第2誘電体層32、反射 層5、第3誘電体層33および保護層6を有する片面記 録型(単板型)媒体を2枚用い、記録層4を内側にして 接着層7により接着したものである。

【0078】図3の光記録媒体において、基体2、第1 誘電体層31、記録層4、第2誘電体層32および保護 層6は、図2に示す光記録媒体と同様な構成である。

【0079】反射層5は、図2の構成よりも光透過率が 40 高い極薄のものであるか、レーザービーム波長が含まれ る近赤外から赤外域にかけての透過性が高いSiやGe 等から構成される。 反射層 5 上に設けられる第3 誘電体 層33は、第1誘電体層31や第2誘電体層32などと 同様な材料から構成すればよいが、好ましくは保護層6 よりも屈折率の高い材料から構成する。

【0080】 審き換え

本発明により製造された光記録媒体に対する書き換え (オーバーライト) は、従来の相変化型光記録媒体と同 様に行われる。記録パワーは、パルス状に加えてもよ

い。一つの信号を少なくとも2回の照射で記録すること により記録マークでの蓄熱が抑制され、記録マーク後端 部の膨れ(ティアドロップ現象)を抑えることができる ので、C/Nが向上する。また、パルス状照射により消 去率も向上する。記録パワーおよび消去パワーの具体的 値は、実験的に決定することができる。なお、再生用レ ーザー光には、記録層の結晶状態に影響を与えない低パ ワーのものを用いる。

【0081】記録に際し、レーザー光に対する記録層の 反射層 5 の材質は特に限定されないが、通常、A 1 、A 10 線速度は、通常、O.8~20m/s程度、好ましくは 1. 2~16m/sである。

> 【0082】上記組成の光記録媒体は、書き換えおよび 再生に用いる光を、広い波長域、例えば100~500 Onmの範囲から自在に選択できる。

[0083]

【実施例】以下、本発明の具体的実施例を示し、本発明 をさらに詳細に説明する。

【0084】実施例1

射出成形によりグループを同時形成した直径130㎜、 る。この保護層は種々の有機系の物質から構成されるこ 20 厚さ0.6㎜のディスク状ポリカーボネート基板2の表 面に、第1誘電体層31、記録層4、第2誘電体層3 2、反射層5および保護層6を形成し、図2の構成を有 する光記録ディスクとした。グループは、幅0.74μ m、深さ65nm、ピッチ1. 48μmとした。

> 【0085】第1誘電体層31は、スパッタ法により形 成した。ターゲットには、2nS(85モル%)-Si O₂ (15モル%) を用いた。第1誘電体層の厚さは2 4 0 nmとした。

【0086】記録層4は、スパッタ法により形成した。 30 記録層の組成は、

式 [(InaAgbTe1-a-b)1-cSbc]1-dVd において

a = 0.18

b = 0.19

c = 0.61

d = 0.02

とした。記録層の厚さは16mmとした。

【0087】第2誘電体層32は、第1誘電体層31と 同様にして形成した。第2誘電体層の厚さは22mmとし

V= 2%

【0088】反射層5は、Auターゲットに用いてスパ ッタ法により形成した。反射層の厚さは150mmとし

【0089】保護層6は、紫外線硬化型樹脂をスピンコ ート法により塗布後、紫外線照射により硬化して形成し た。硬化後の保護層厚さは5 μmであった。

【0090】このようにして作製した光記録ディスクに 対し、本発明にしたがって改質処理および結晶化処理を 施し、これをサンプルNo. 101とした。また、この光 50 記録ディスクに対し、従来の方法で初期化処理を施し、

これをサンプルNo. 102とした。

【0091】サンプルNo.101における改質処理に際しては、線速度を12m/sとし、レーザービームのパワーを800mWとし、ビームスポットの送りをサンプル1回転あたり60μmとし、パルス変調周数を9MHzとし、パルスのデューティー比を50%とした。結晶化処理は、光記録ディスクを光記録媒体評価装置に載せ、線速度5m/sで回転させながら、8mWのレーザービームを1トラックごとに照射することにより行った。結晶化処理後、最適記録パワーは11.0mW、消去パワーは4.0 10mWであった。なお、この場合の消去パワーは、最も高い消去率が得られるパワーのことである。

【0092】サンプルNo. 102における初期化処理は、線速度を3m/sとし、レーザービームのパワーを730 Wとし、ビームスポットの送りをサンプル1 回転あたり 66μ mとして行った。初期化処理後、最適記録パワーは9.3mW、消去パワーは4.1mWであった。

【0093】サンプルNo.101の結晶化処理後の反射率は21%であり、サンプルNo.102の初期化処理後の反射率は24%であり、両サンプルに線速度12m/sで1-7RLL変調の信号を繰り返しオーバーライトした後の消去部(結晶化部)の反射率は20%であった。なお、これらの反射率は全トラックでの平均値である。この結果から、従来の初期化処理後の記録層は繰り返しオーバーライト後の消去部よりも反射率が高くなっているが、初期化処理に替えて改質処理および結晶化処理を施した場合には、結晶化処理後の反射率が繰り返しオーバーライト後の反射率とほぼ同じとなっていることがわかる。すなわち、本発明にしたがって処理されたサンプルNo.101では、「なじませ」処理が不要であることがわかる。

【0094】また、これらのサンプルに上記オーバーライトを繰り返し行い、8T信号のリーディングエッジ・ジッターのオーバーライト回数依存性を調べた。結果を図4に示す。

【0095】図4において、従来の初期化処理を施したサンプルでは、20回の繰り返しオーバーライトの間にジッターが一度増大しその減少して安定する傾向を示している。このジッターの増大と減少とは、「なじませ」処理の効果に相当すると考えられる。そして、オーバー 40ライトを1000回繰り返したときには、ジッターが急激に増大してしまっている。これに対し、高周波パルス変調による改質処理および結晶化処理を施したサンプルでは、初回のオーバーライトからジッターが小さく、しかも安定しており、オーバーライト1000回後にもジッターが急激に増大することはなく、オーバーライト可能回数が増えていることがわかる。サンプルNo.102が初回のオーバーライト時からジッターがサンプルNo.10

16

や誘電体層のダメージのためと考えられる。

【0096】実施例2

実施例1で作製した光記録ディスクに、線速度4m/sで回転させながらレーザーピームを照射することにより、改質処理を施した。レーザーには、デューティー比50%でパルス変調したものを用い、レーザーパワーは700mWとし、ピームスポットの送りはサンプル1回転あたり60μmとした。

【0097】改質処理後、サンプルを光記録媒体評価装置に載せ、線速度5m/sで回転させながら、8mWのレーザービームを1トラックごとに照射することにより、結晶化処理を施した。

【0098】改質処理の際のパルス変調周波数の異なる 各サンプルについて、結晶化処理後の平均反射率を求め た。平均反射率は、最高値R_tと最低値R_bとから、

 $(R_t+R_b)/2$

により算出した。なお、反射率は全トラックについて測定した。また、比較のために、従来の初期化処理を施した比較サンプルについても、同様な測定を行った。結果 20 を図5に示す。なお、比較サンプルの初期化は、線速度を3m/sとし、レーザービームのパワーを700Wとし、ビームスポットの送りをサンプル1回転あたり60μmとして行った。この比較サンプルのデータは、変調周波数ゼロの位置にプロットしてある。

【0099】実施例1において測定した繰り返しオーバーライト後の反射率と図5との比較から、パルス変調周波数が高くなるほど反射率が低くなって繰り返しオーバーライト後の反射率に近づくことがわかる。すなわち、図1(a)において、結晶状態D'が結晶状態Dに近づ30くことがわかる。

【0100】また、改質処理の際のバルス変調周波数の 異なる各サンプルについて、結晶化処理後の反射率の変 動率を求めた。なお、この変動率は、平均の反射率に対 する変動率であり、

2 $(R_t-R_b) / (R_t+R_b)$

により算出した。また、比較のために、通常の初期化処理を施した上記比較サンプルについても変動率を求めた。これらの結果を図6に示す。なお、比較サンプルのデータは、変調周波数ゼロの位置にプロットしてある。【0101】図6に示される結果から、レーザービームをパルス変調した場合には周波数が高くなるほど変動率が低くなり、変動率10%以下を達成できることがわかる

では、初回のオーバーライトからジッターが小さく、し 【0102】図7は、トラック1周分の反射率変動を示かも安定しており、オーバーライト1000回後にもジッターが急激に増大することはなく、オーバーライト可能回数が増えていることがわかる。サンプルNo.102 たしのであり、図7(b)は、通常の初期化処理を施しが初回のオーバーライト時からジッターが大きく、オーバーライトを繰り返してもジッターがサンプルNo.10 7(b)に比べ反射率変動が極めて小さく、また、緩や2と同等まで減少しないのは、初期化処理の際の記録層 50 かである。すなわち図7(a)では、ジッターの増大に

影響する反射率変動、特に短周期の反射率変動が、図7 (b) に比べ著しく少ない。なお、図7(b) に示す反 射率変動は、繰り返しオーバーライト後も消失しなかっ たので、初期化処理による記録層や誘電体層のダメージ によるものと考えられる。

【0103】実施例3

実施例1で作製した光記録ディスクに対し、パルス変調 周波数を図8に示す値としたほかは実施例2と同様にし て改質処理および結晶化処理を施し、測定用サンプルと ター評価を行った。ただし、ディスクの線速度は6m/s とした。また、比較のために、通常の初期化処理を施し た比較サンプル (実施例2の比較サンプル) についても 同様な評価を行った。なお、この比較サンプルのデータ は、変調周波数ゼロの位置にプロットしてある。結果を 図8に示す。

【0104】図8に示される結果から、従来の初期化処 理に替えて改質処理および結晶化処理を施すことにより ジッターが減少し、パルス変調周波数が高くなるほどジ ッター減少量が大きくなることがわかる。従来の初期化 20 処理を施した比較サンプルではジッターが 6 nsを超えて おり、使用不能である。なお、図8では図4に対しジッ ターの絶対値が約2倍となっているが、これは図8にお ける線速度が図4における線速度の1/2だからであ

【0105】 実施例4

改質処理においてレーザービームをパルス変調せず、改 質処理時のディスクの線速度を図9に示すものとしたほ かは実施例2と同様にして光記録ディスクを作製した。 これらの光記録ディスクについて、実施例2と同様にし 30 て結晶化処理後の反射率の変動率を求めた。結果を図9 に示す。

【0106】図9では、従来の初期化処理に近い低線速 度での改質処理のときには反射率変動が大きくなってい るが、改質処理を高線速度で施したときには反射率変動 が低く抑えられている。具体的には、線速度7m/sでは 反射率変動が10%程度に下がっている。この光記録デ ィスクの書き換え可能な線速度が6m/sであることを考 えると、レーザービームをパルス変調しなくても、ディ ーザーを照射することにより、パルス変調を利用した場 合と同等の改質処理が可能であることがわかる。

【0107】実施例5

記録層の組成(原子比)を、

式 Ge. Sb, Te1-a-b

において

a = 0.22

b = 0.22

とし、記録層の厚さを20mmとし、第1誘電体層の厚さ

18

射層の厚さを100mとしたほかは実施例1と同様にし て光記録ディスクを作製した。この光記録ディスクに、 実施例1のサンプルNo.101と同様にして改質処理お よび結晶化処理を施して光記録ディスクサンブルNo. 6 01を作製し、一方、前記光記録ディスクにサンプルド o. 102と同様にして通常の初期化処理を施したサンプ ルNo. 602を作製した。

【0108】サンプルNo. 601および602につい

て、反射率変動およびジッターの測定を行ったところ、 した。これらのサンプルについて実施例2と同様なジッ 10 上記各実施例と同様に、本発明にしたがって改質処理お よび結晶化処理を施すことによる効果が認められた。 【0109】なお、従来の初期化処理による問題点を確 認するために、サンプルNo. 602にオーバーライトを 行った後、反射層を剥離し、次いでポリカーポネート基 板をクロロフォルムで溶解し、さらに、フッ酸でエッチ ングすることにより第1誘電体層および第2誘電体層を 除去して、記録層だけを取り出した。この記録層の透過 型電子顕微鏡写真を図10に示す。図10に示す写真 を、図11を用いて説明する。図中の中央付近に存在す る長円形の暗部の一部(暗部内の下側1/5程度)は、 記録マーク(非結晶状態C)であり、実質的に無構造で ある。暗部内の残りの4/5程度はオーバーライト時に 消去された領域(結晶状態D)であり、比較的細かい結 晶粒から構成されている。一方、長円形の暗部を囲む領 域は、初期化処理により形成された結晶化部(結晶状態 B) であり、大きな結晶粒から構成されている。従来の 初期化処理後、反射率が安定するまでに前述した「なじ ませ」処理が必要なのは、結晶状態Bと結晶状態Dとの 結晶性の違いによることが、図10に明瞭に示されてい

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a) は、本発明法の説明図であり、(b) は、従来の初期化法の説明図である。

【図2】本発明の光記録媒体の構成例を示す部分断面図 である。

【図3】本発明の光記録媒体の構成例を示す部分断面図

【図4】本発明により製造された光記録ディスクと、従 来の初期化処理を施した光記録ディスクとについて、オ スクの書き換え可能線速度に近い線速度においてDCレ 40 ーバーライト回数とジッターとの関係を示すグラフであ る。

> 【図 5】 改質処理の際のパルス変調周波数と、結晶化処 理後の平均反射率との関係を示すグラフである。

> 【図6】改質処理の際のパルス変調周波数と、結晶化処 理後の反射率の変動率との関係を示すグラフである。

【図7】オシロ波形を表す図面代用写真であって、

(a) は、本発明により製造された光記録ディスクのト ラック1周あたりの反射率変動を示すグラフであり、

(b) は、従来の方法により初期化された光記録ディス を110nmとし、第2誘電体層の厚さを25nmとし、反 50 クのトラック1周あたりの反射率変動を示すグラフであ

る。

【図8】改質処理の際のパルス変調周波数と、ジッター との関係を示すグラフである。

【図9】改質処理の際の光記録ディスクの線速度と、反 射率の変動率との関係を示すグラフである。

【図10】結晶構造を表す図面代用写真であって、従来 の初期化処理が施された記録層の透過型電子顕微鏡写真 である。

【図11】図10の透過型電子顕微鏡写真の説明図であ る。

【符号の説明】

- 2 基体
- 31 第1誘電体層
- 32 第2誘電体層
- 33 第3誘電体層
- 4 記録層
- 5 反射層
- 6 保護層
- 7 接着層

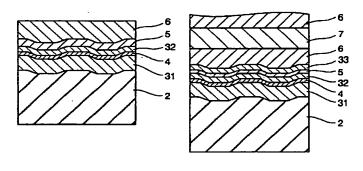
10

【図5】

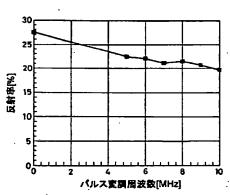
20

【図2】

【図3】



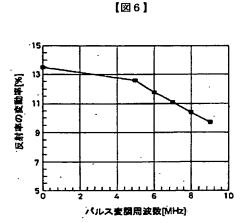
【図4】

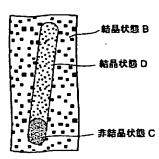


- 本発明法 - 従来の初期化 5 ジンター(ns) 4 1 0 10 100 1000

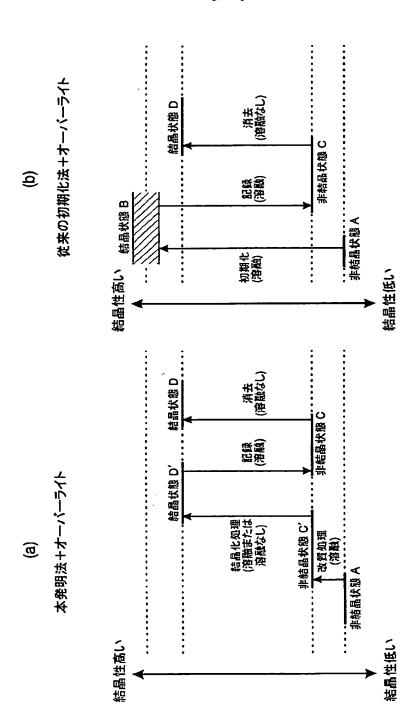
オーバーライト回数

【図11】



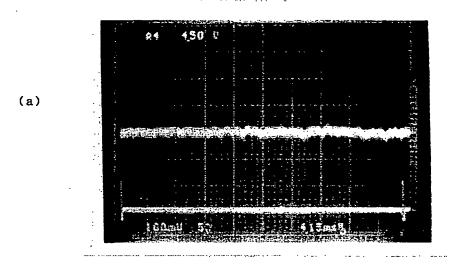


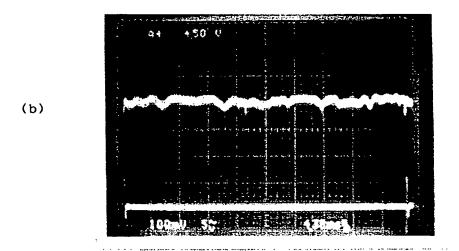
【図1】



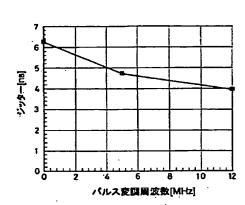
【図7】

図面代用写真

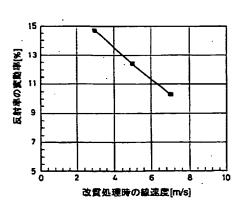








【図9】



[図10]

図面代用写真

